

The background of the slide is a futuristic cityscape rendered in shades of blue and white. The buildings are stylized and integrated with a complex network of circuitry and data lines. A bright light source in the upper right corner creates a lens flare effect. The word "EBRAIN" is prominently displayed in the center in a bold, red, italicized font with a white outline.

EBRAIN

第5 3期通期会社説明資料

- 会社概要
- 事業内容の説明
- 2026年3月期(第53期)通期決算状況
- 2027年3月期(第54期)通期見通し
- 成長への取り組み

設	立	1973年（昭和48年）10月		
本	社	東京都八王子市石川町		
資	本	金	1億4,301万円	
売	上	高	39億9,300万円（2026年3月期）	
経	常	利	益	5億5,000万円（同上）
従	業	員	数	117名（2026年3月現在）
事	業	所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区	
子	会	社	蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市）	
事	業	内	容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

- 現在のメインの仕事内容は、
通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および
半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、
コントローラとして使用される**産業用コンピュータ**の
受託設計と受託生産が中心で、売上の80%以上を占めています。

通信・放送



- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、
大手の装置メーカーが主契約者となっていて、私どものビジネスのポジシ
ョンとしては、その下になります。

鉄道



- 主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、
当社へ委託するコンピュータ製品の「**要求仕様書**」を作成して提示し、
私共はその「**要求仕様**」に基づいて**製品を設計**し、試作品を作って装置
メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

医療

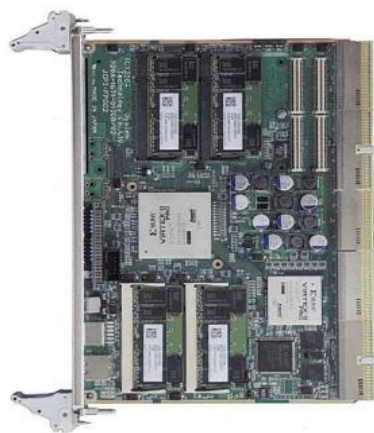


- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、
量産開始以降は中長期的に安定した製品供給を要求されます。

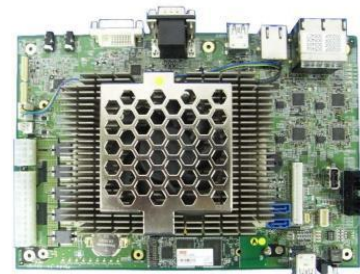
半導体製造装置



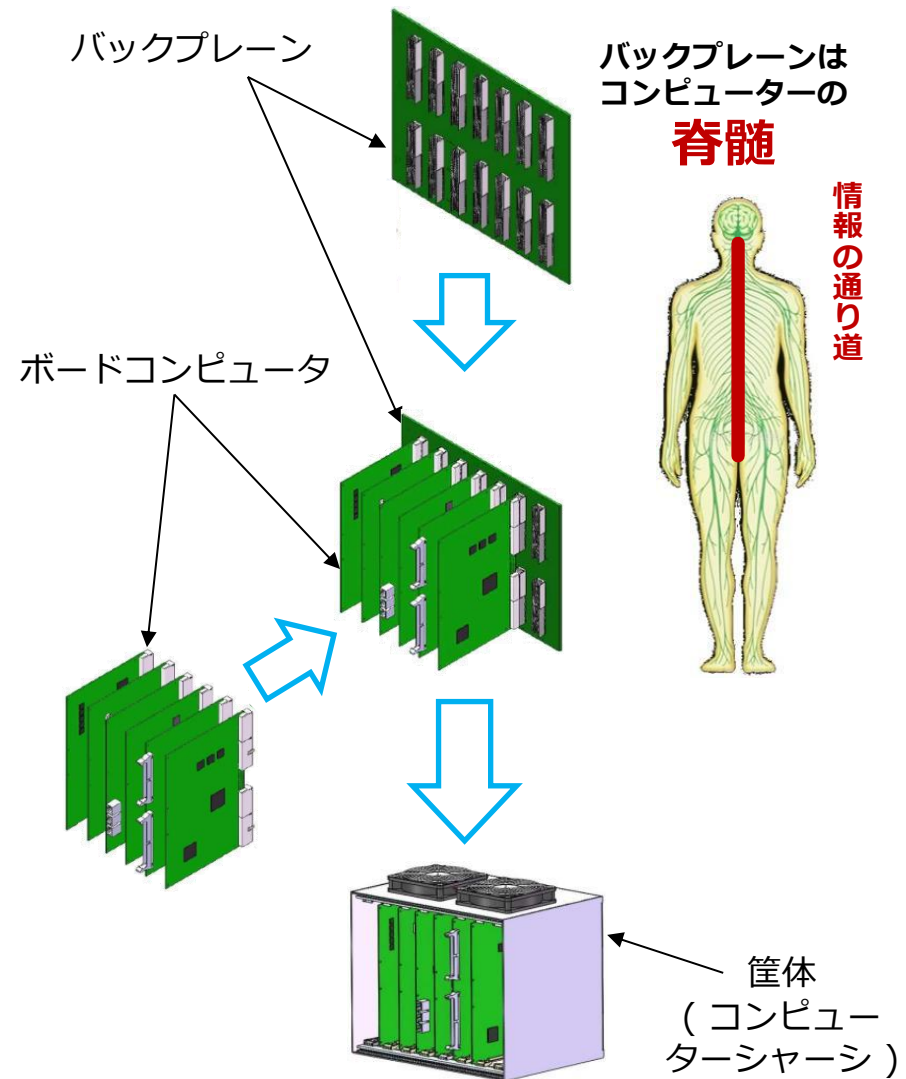
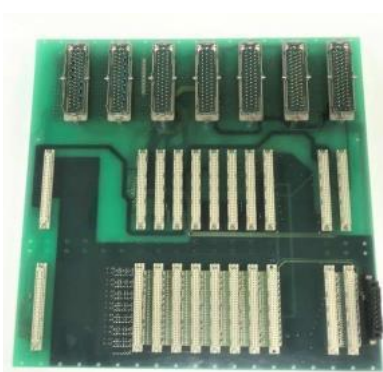
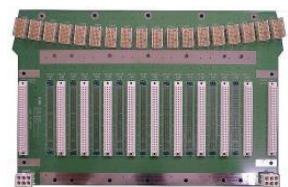
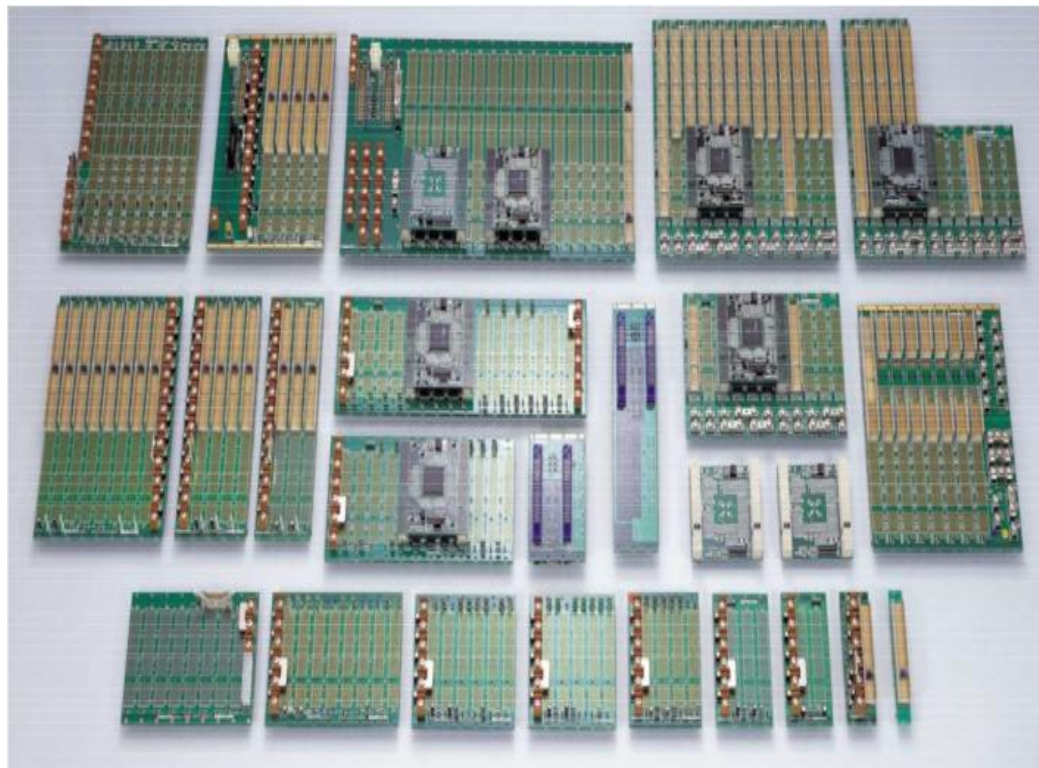
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン

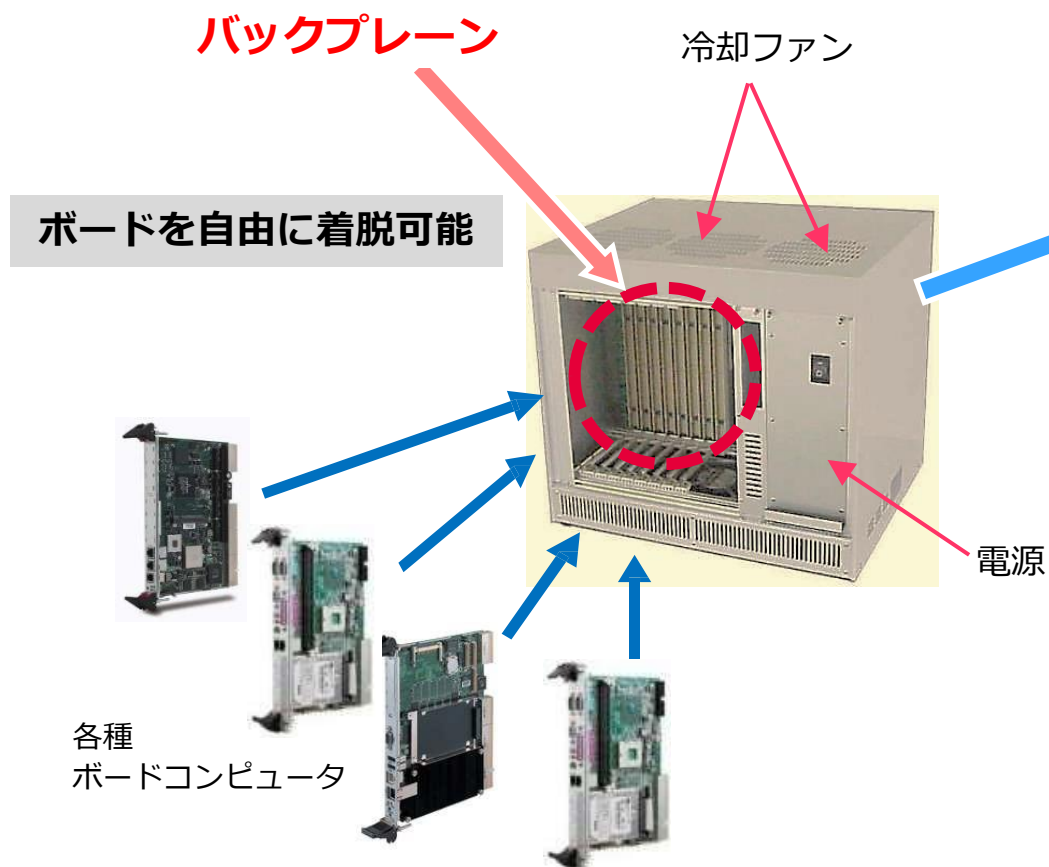


- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)





(例・半導体製造装置)

バックプレーン

【役割】
各種回路基板を相互に接続して
信号伝送や電力供給を行う

冷却ファン

筐体

ガイドレール

電源



ボードコンピュータ

【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1. 保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2. 拡張性

拡張スロット、増設、
機能追加、

3. 汎用性

市場に流通しているボードコンピュー
タを採用する事が可能。

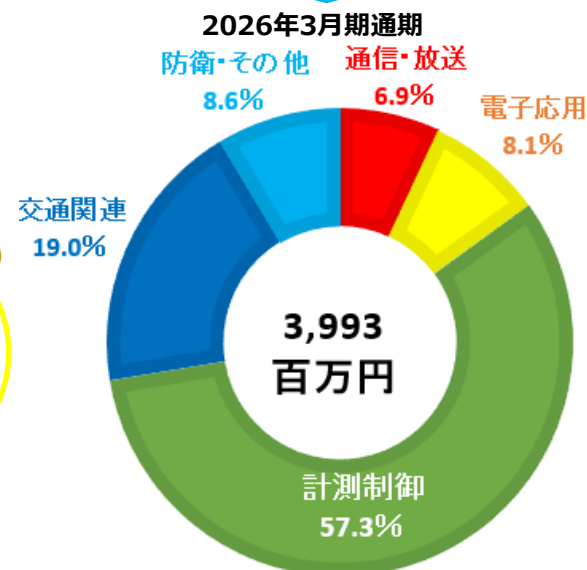
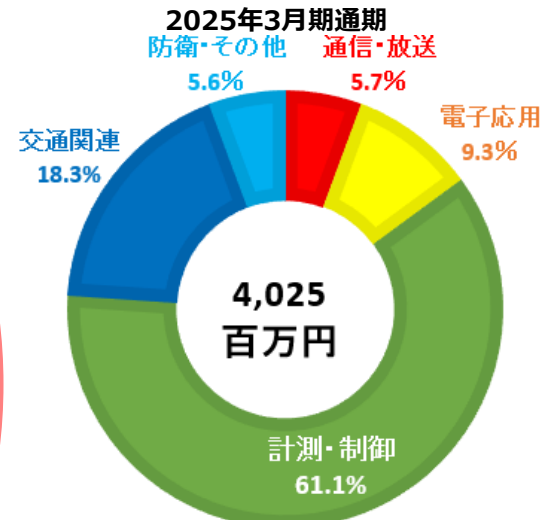
多くの産業用コンピュータで
バックプレーン方式が採用される

エブレン製品の用途（応用分野）

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続



連結売上高構成前年同期比



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

各分野の主要メーカーへ納入

NEC

NEC グループ各社

HITACHI
Inspire the Next

日立製作所
グループ各社

FUJITSU

富士通グループ各社

NUFLARE

(株) ニューフレア
テクノロジー



GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社

ACCRETECH

(株) 東京精密

三菱重工

三菱重工
グループ各社

**MITSUBISHI
ELECTRIC**

三菱電機
グループ各社

Kawasaki

川崎重工業
グループ各社

TEL

東京エレクトロン
グループ各社

Canon

キャノンメディカル
システムズ (株)

古河電工

古河電気工業 (株)

KYOSAN

(株) 京三製作所

GIGAPHOTON

ギガフォトン

Panasonic TOSHIBA

パナソニック
グループ各社

東芝 グループ各社



日本アビオニクス (株)

Lasertec

レーザーテック (株)

JEOL

日本電子 (株)

SCREEN

(株) SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

viswill

第一実業ビスウィル (株)

日本信号株式会社

日本信号 (株)

SONY

ソニーグローバル
マニュファクチャリング&
オペレーションズ

MEIDEN

(株) 明電舎

**TOKYO
KEIKI**

東京計器 (株)

ULVAC

(株) アルバック

Nikon

(株) ニコン

santec

Santec Holdings (株)

ONO SOKKI

(株) 小野測器

BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産



自社開発のプレスフィットマシンとボードチェッカーを八王子、入間、大阪、蘇州の4拠点に設置、どの生産拠点でも同じように生産できる体制をとっています。



蘇州惠普聯電子有限公司
(中華人民共和国江蘇省)
・設計・開発
・生産

大阪事業所
(大阪市東淀川区)
・設計・開発
・生産

本社・八王子事業所
(東京都八王子市)
・設計・開発
・生産

上野事業所
(東京都荒川区)
・設計・開発

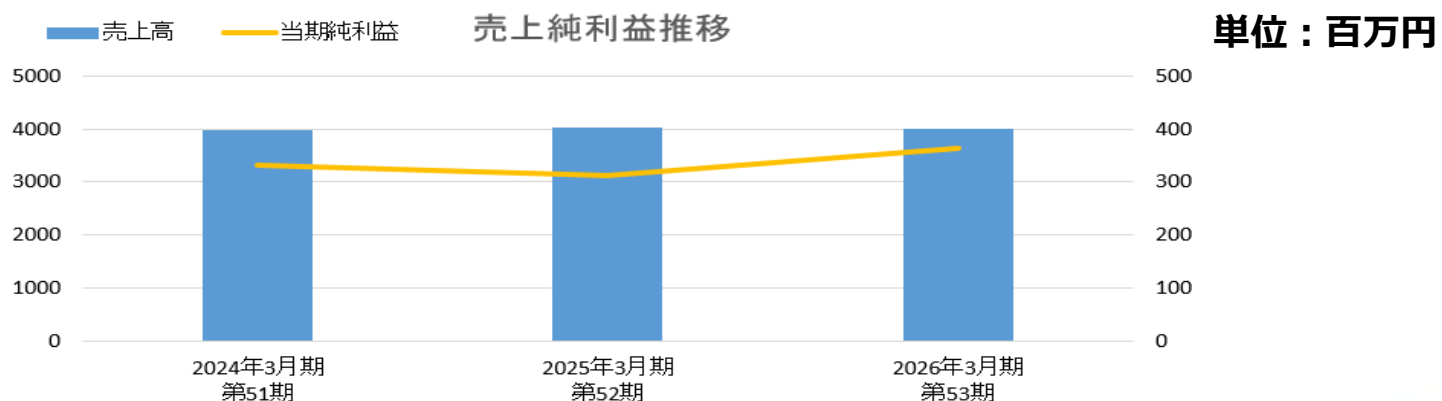
入間事業所
(埼玉県入間市)
・生産



2026年3月期（53期）通期業績報告

2026年3月期 (第53期) 通期決算実績

連結損益計算書	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期	前期比
売上高	3,987	4,025	3,993	99.2%
営業利益	486	464	530	114.2%
営業利益率	12.1%	11.5%	13.2%	
経常利益	490	475	550	115.8%
経常利益率	12.2%	11.8%	13.7%	
当期純利益	332	313	364	116.3%
当期純利益率	8.3%	7.7%	9.1%	





計測・制御（半導体製造装置・FA製品等）

- ✓ 回復基調に入るのが3か月程度遅れ第4四半期からとなった
- ✓ EV関連検査装置の設備投資減少
- ✓ 売上は前年比**6.9%減**

2,459万円→2,289百万円（169百万円↓）



交通関連（鉄道・高速道路等）

- ✓ 新規案件の増加
- ✓ 海外向け案件が好調
- ✓ 売上は前年比**3.1%増**

736百万円→759百万円（23百万円↑）



通信・放送・電力

- ✓ AIサーバー需要増に伴う電力網強化に関連する新規案件増加
- ✓ 売上は前年同期比**21.1%増**
228百万円→277百万円（48百万円↑）



電子応用（医療・生命科学・HPC 等）

- ✓ 中国向け医療機器の売上減少
- ✓ 医療関連市場のトレンドは堅調
- ✓ 売上は前年同期比**13.5%減**
374百万円→323百万円（50百万円↓）

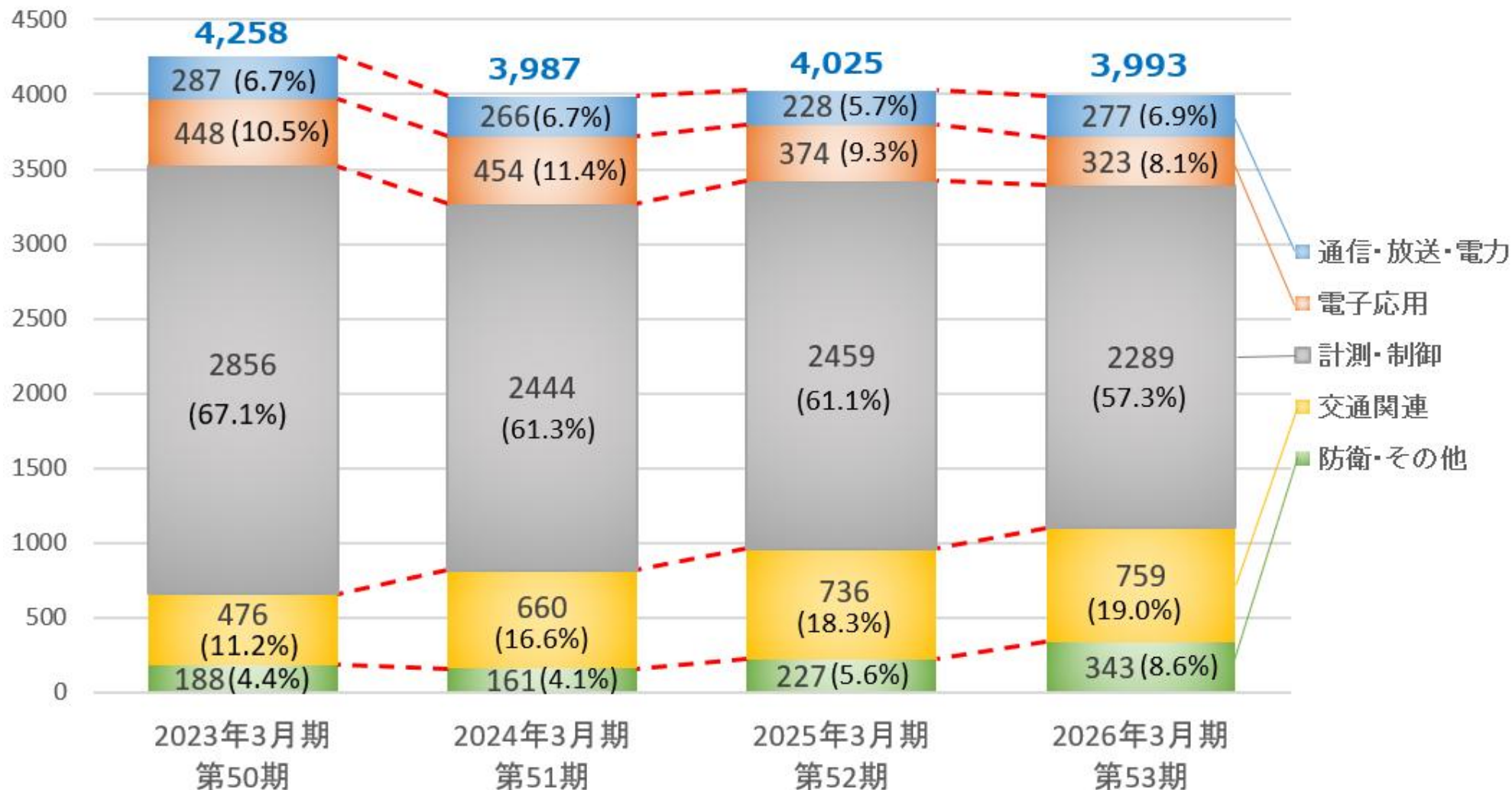


防衛・セキュリティー

- ✓ 防衛関連の新規案件成約
- ✓ 防衛予算増額による受注量の増加
- ✓ 売上は前年同期比**51.2%増**
227百万円→343百万円（116百万円↑）

連結応用分野別売上推移

単位：百万円



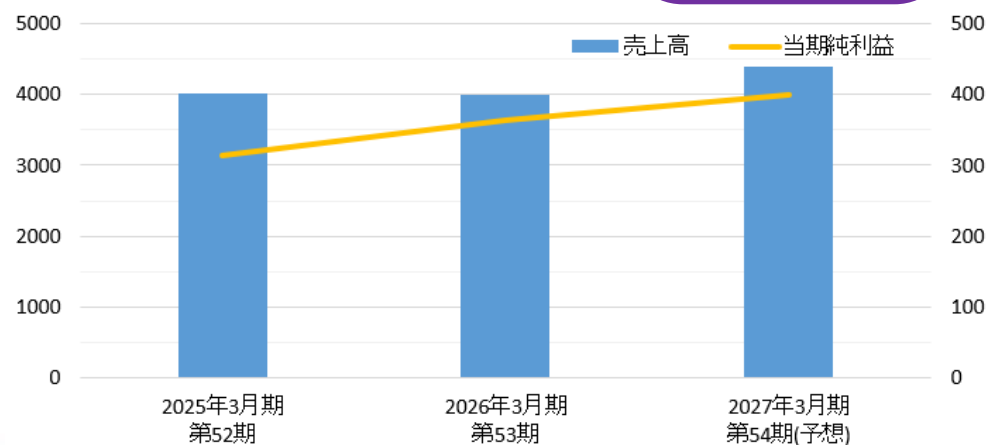
単位：百万円

	2025年3月	2026年3月	前期末比
流動資産	4,645	4,117	88.6%
固定資産	1,258	2,251	179.0%
資産合計	5,904	6,368	107.9%
流動負債	706	845	119.6%
固定負債	411	419	102.1%
負債合計	1,117	1,264	113.1%
純資産	4,786	5,104	106.6%
負債純資産合計	5,904	6,368	107.9%
自己資本比率	81.1%	80.1%	-1.0%

2027年3月期 通期業績予想

単位：百万円

連結損益計算書	2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期 見通し	増減率
売上高	4,025	3,993	4,400	110.2%
営業利益	464	530	620	116.9%
営業利益率	11.5%	13.2%	14.0%	
経常利益	475	550	620	112.6%
経常利益率	11.8%	13.7%	14.0%	
当期純利益	313	364	400	109.8%
当期純利益率	7.7%	9.1%	9.0%	
1株当たりの配当	40円	48円	58円	





計測・制御（半導体製造装置）

- ✓ SEAJ（日本半導体製造装置協会）が前年度比12%増加予想を発表
- ✓ HBMや先端ロジックへの投資拡大が成長をけん引
- ✓ 各社半導体製造装置メーカーの在庫調整は解消
- ✓ 前年度比25.8%増を見込む



交通関連

- ✓ 鉄道案件及び信号案件共に設置完了、生産終息案件増加
- ✓ 前期末に前倒し納入した影響により出荷数減少
- ✓ 前年度比21.0%減を見込む



通信・放送・電力

- ✓ 通信・放送分野は低調に推移する見込み
- ✓ 電力分野は堅調、新規案件増加
- ✓ 前年度比9.8%減を見込む



電子応用

- ✓ 医療機器の中国生産品の生産減少
- ✓ 一部顧客で電子顕微鏡案件が終息
- ✓ 顧客で継続していた生産調整は終了し受注回復
- ✓ 前年度比1.2%減を見込む

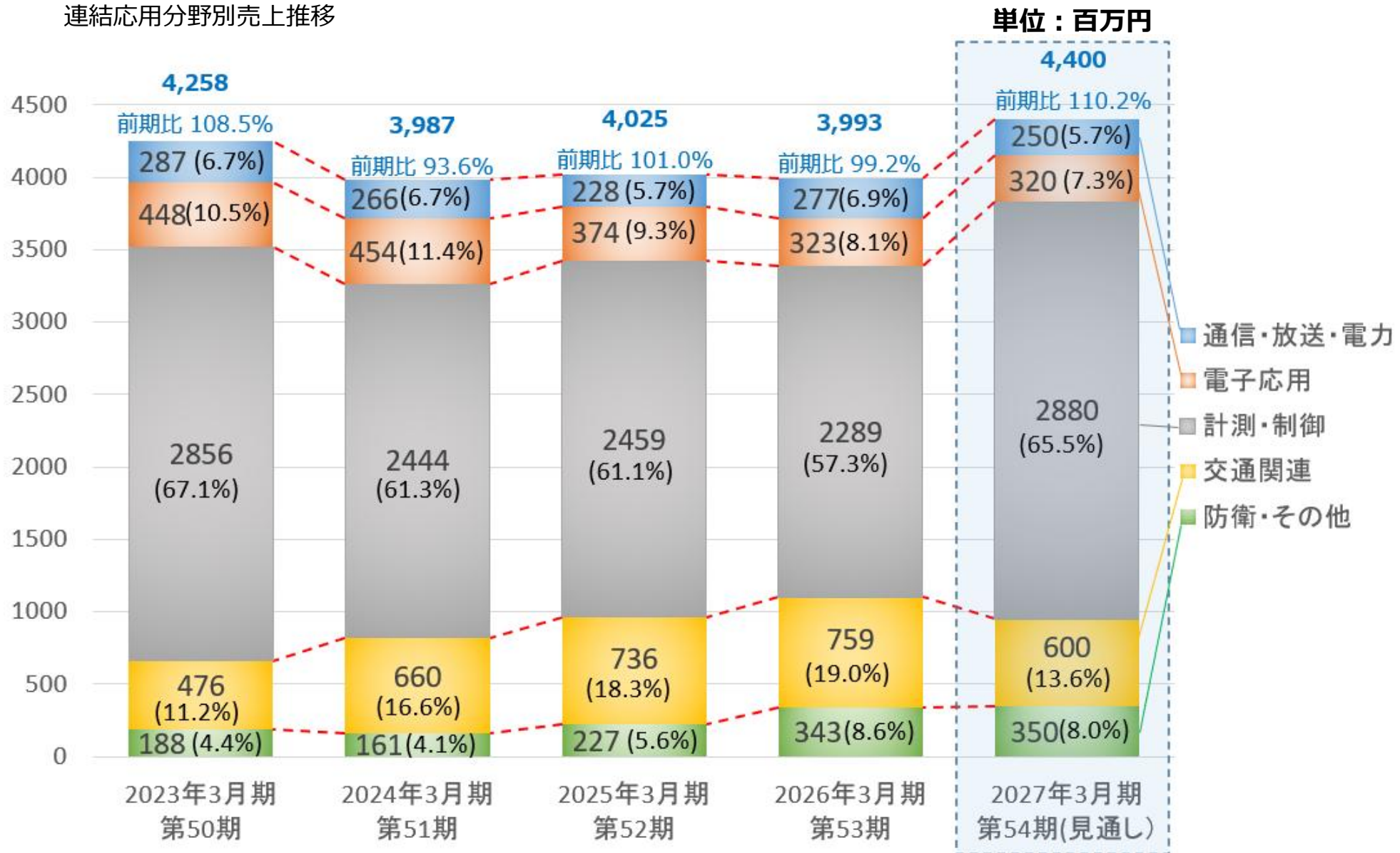


防衛・セキュリティー・その他

- ✓ 防衛予算増額により前年からの好調を維持
- ✓ 前年度比1.9%増を見込む

2027年3月期（第54期）応用分野別売上予想

連結応用分野別売上推移





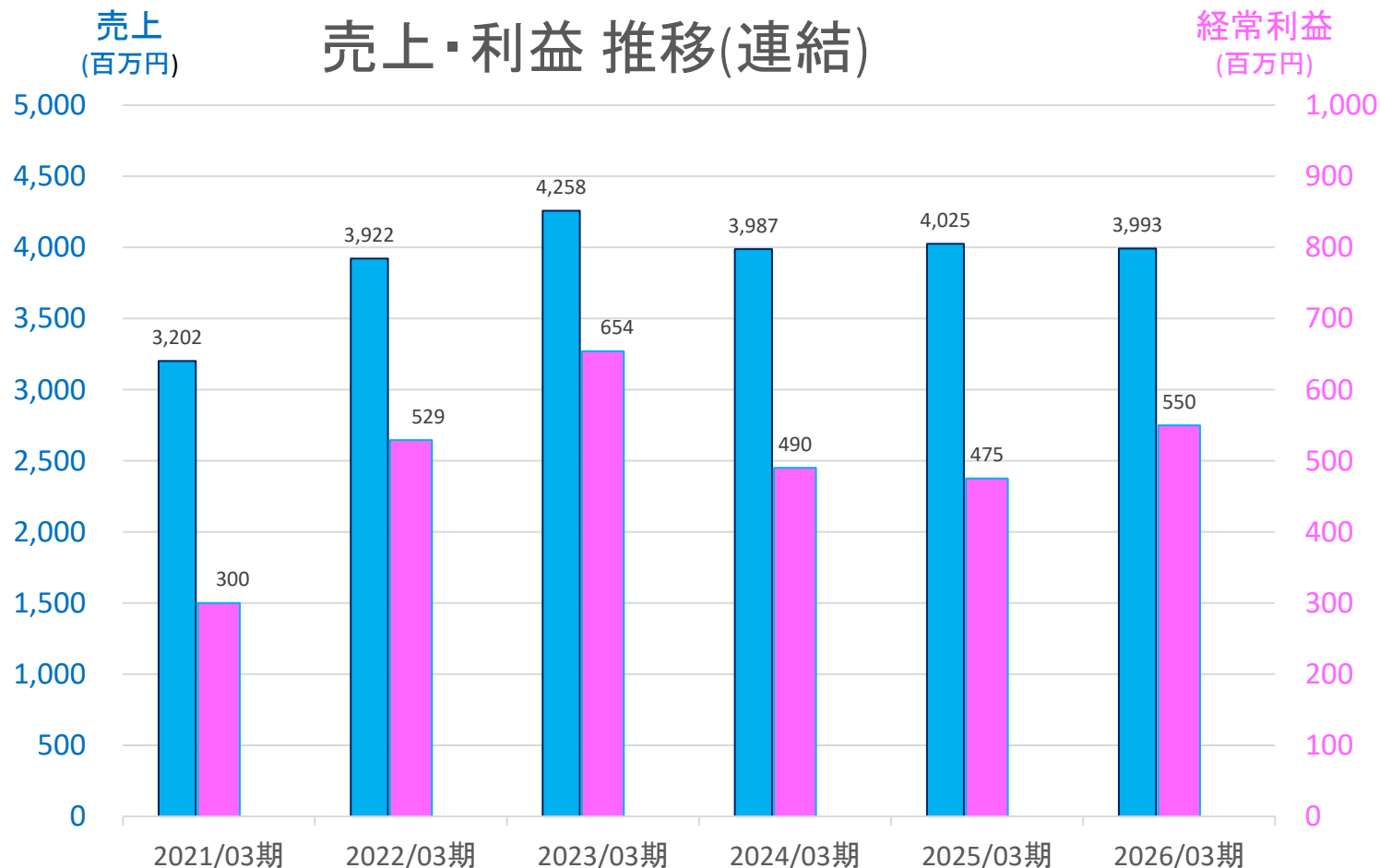
成長への取り組み

上場以降の業績推移

2021年3月期 売上：32億円
(上場第1期) 経常利益：3.0億円



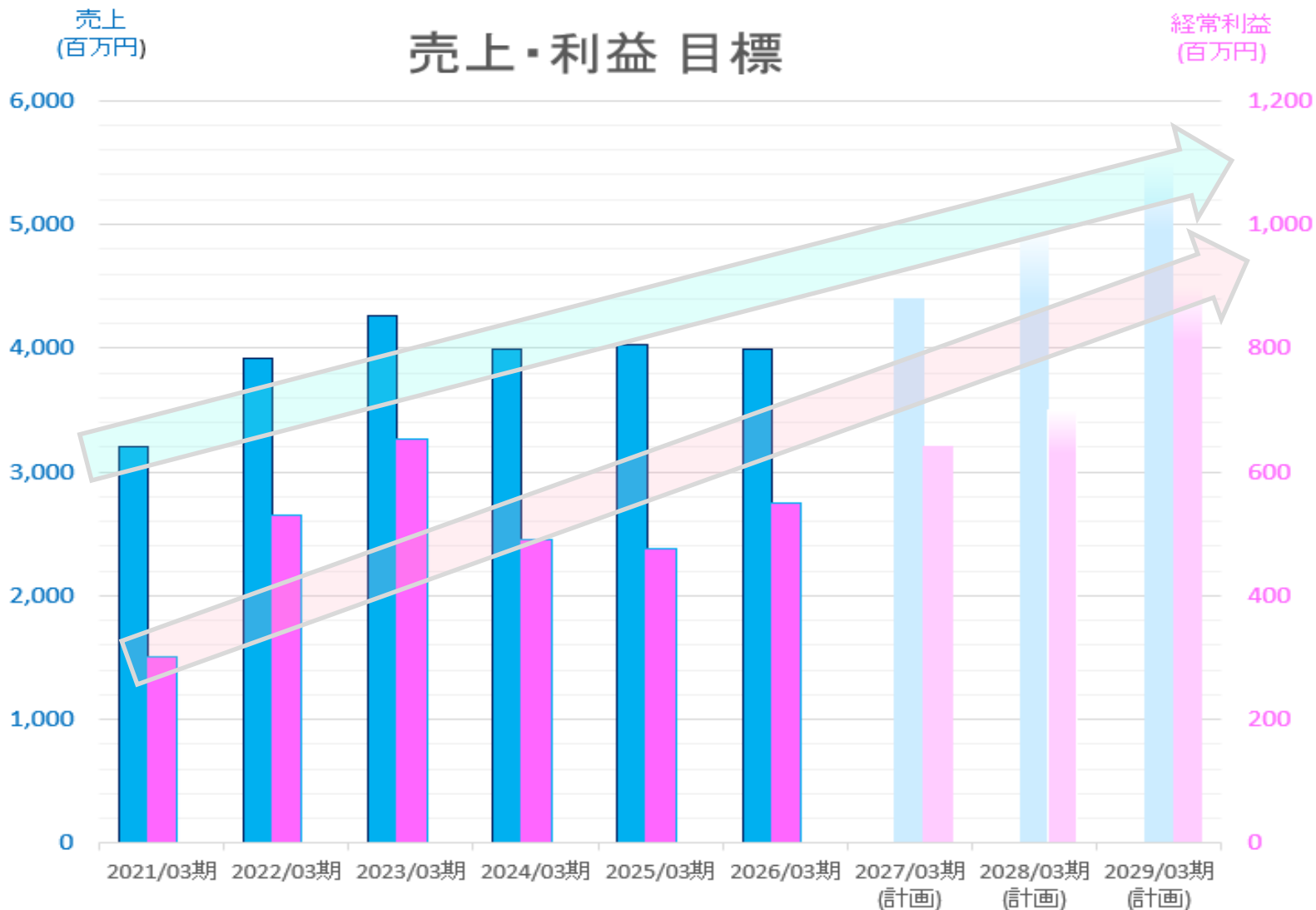
2026年3月期 売上39.9億円
2026期3月期 経常利益 5.5億円(CAGR12.8%)



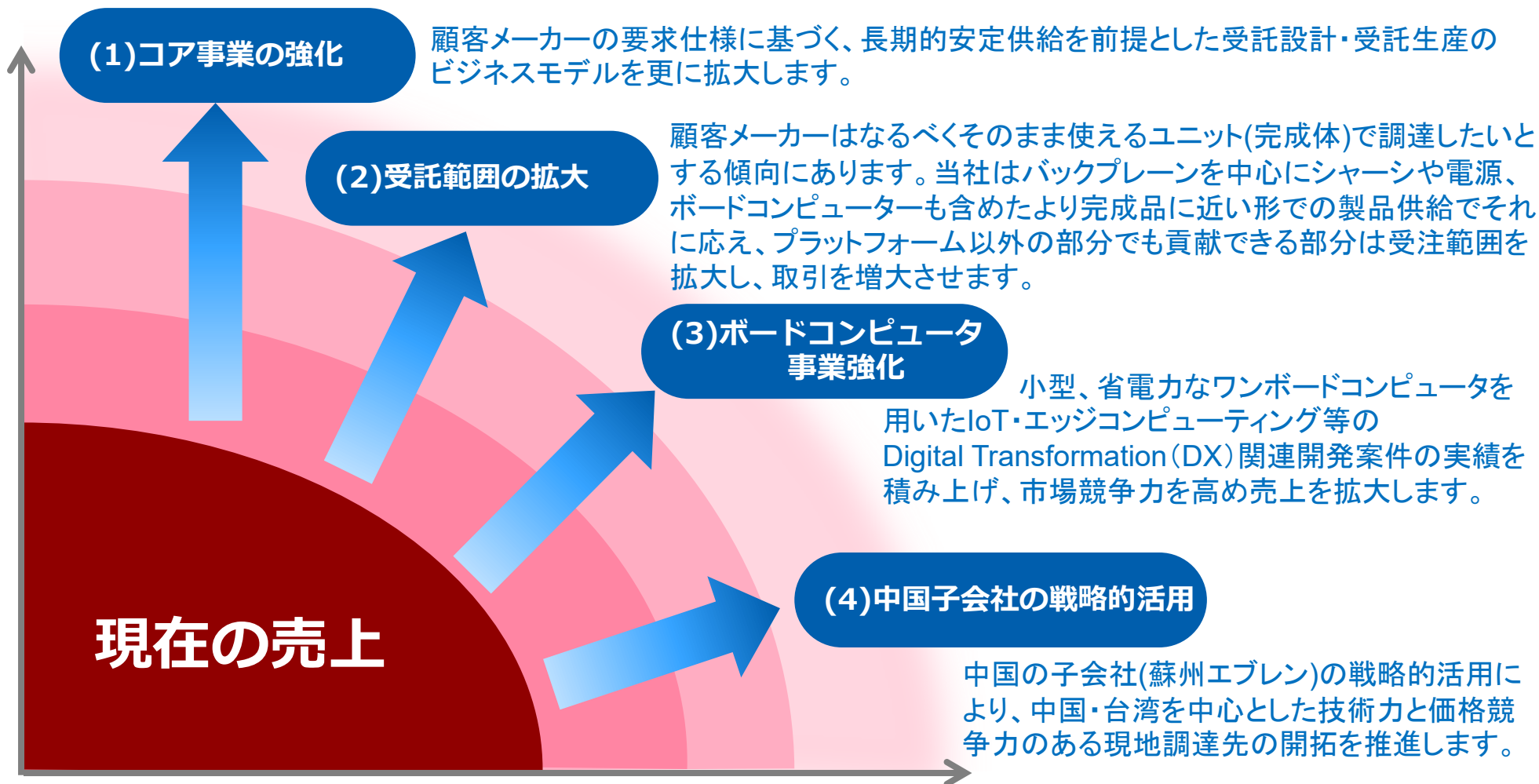
当面の目標

年率10%~15%成長を目標として成長路線を堅持

2029年3月期（56期）に売上55億円、経常利益8.5億円を目指す



より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専門メーカーとの協業が拡大する

専門メーカーとしての優位性（**短納期・低コスト・高品質**）を生かし顧客メーカーとの協業を通じてノウハウや設計資産を蓄積

- ・類似案件の受注拡大
- ・事業領域の拡大
- ・要素技術の開発・拡充
(**冷却構造、耐電磁波構造等**)
- ・部品共通化による調達力の強化
- ・標準製品、システムパーツの拡充
(**FANアラームボード、標準部材等**)
- ・生産拡大に伴う生産設備増強

市場における優位性増大 = 事業拡大へ

(2) 受託範囲の拡大

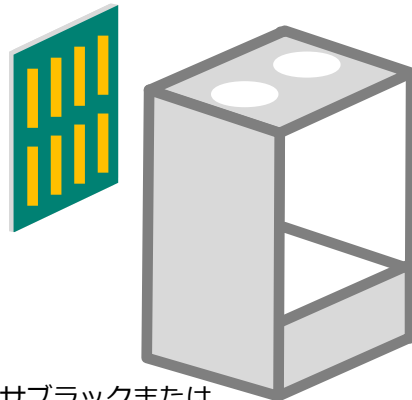
当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、当社の受託範囲がより完成品に近い形となるよう供給体制を整備・拡充し、お客様の多様なニーズに応えます。

バックプレーン・サブラック・シャーシ

それぞれを単体で提供

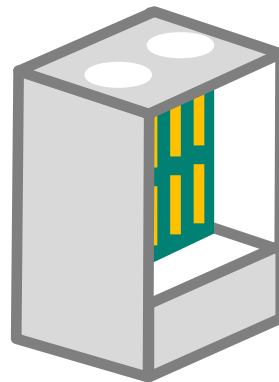
バックプレーン



サブラックまたはシャーシ

バスラック

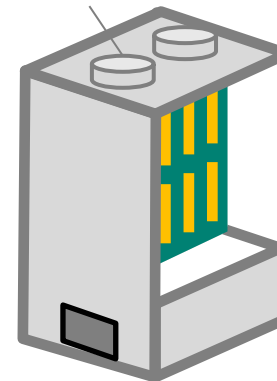
バックプレーンが組込まれたラック・ユニット



システムラック

バスラックに電源やファン等を組込んで結線されたユニット

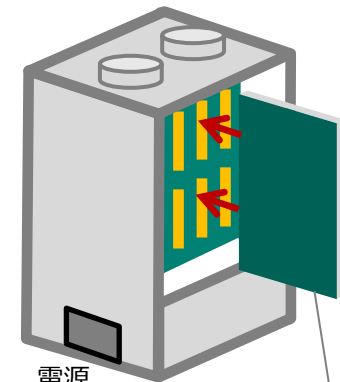
ファン



電源

コンピュータプラットフォーム

CPU回路を備え、ユーザー側の目的に応じてI/Oボードやメモリーボードを実装して使用できるハードウェアプラットフォーム



電源

CPUボード等

年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

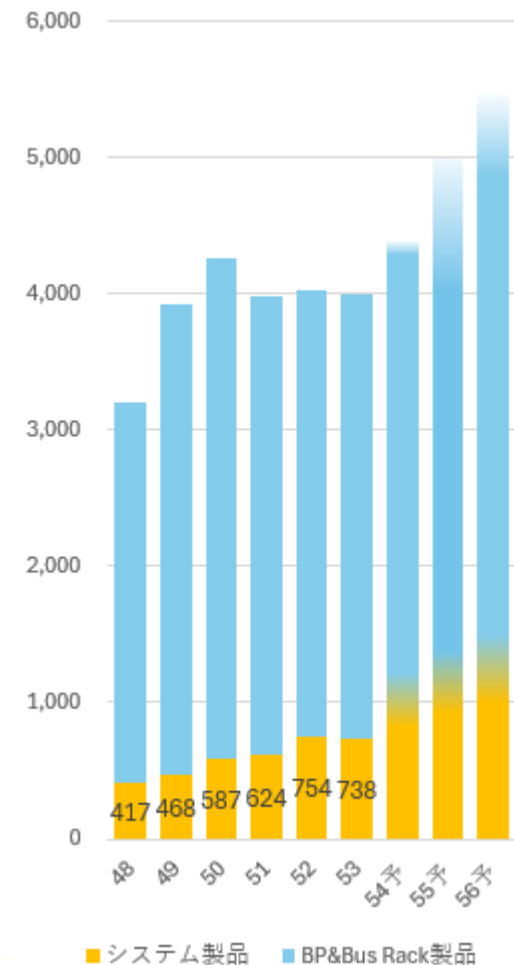
以前から試作を重ねてきた半導体製造装置の主要部位の納入も開始となり
コンピュータプラットフォーム以外の部分で業績拡大

(3) ボードコンピュータ事業強化

技術革新で小型化・低消費電力化が進み、エッジコンピューティング、IoT等、小型ワンボードコンピュータを使用して実現するFAシステム、DX(Digital Transformation)関連の開発案件が増加している。
パートナーシップを含む技術部門の増強を図り製品開発力の向上を目指す。

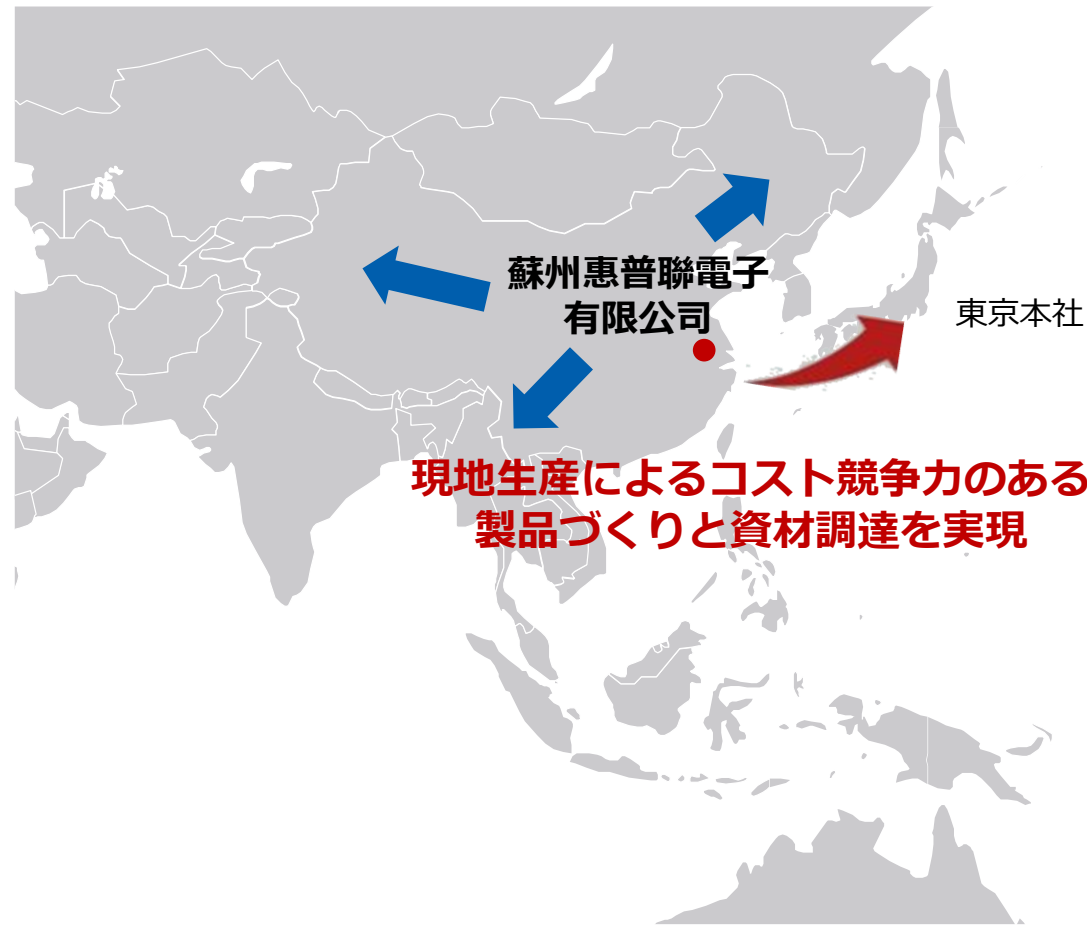
- ・基板検査用制御装置（マイクロプロセッサ用途）
- ・次世代ワイヤードンダーコントローラー（システム制御）
- ・信号変換/演算ボード（光学特性検査装置）
- ・高速モーションコントローラー（半導体製造装置用途）
- ・半導体製造装置用制御部（ビーム描画装置）
- ・除振装置用コントローラー（精密機械用途）
- ・ECU(Electronic Control Unit)検査装置
- ・監視カメラ（セキュリティ用途）
- ・レーダー制御装置

※現在進行中の開発案件抜粋



(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



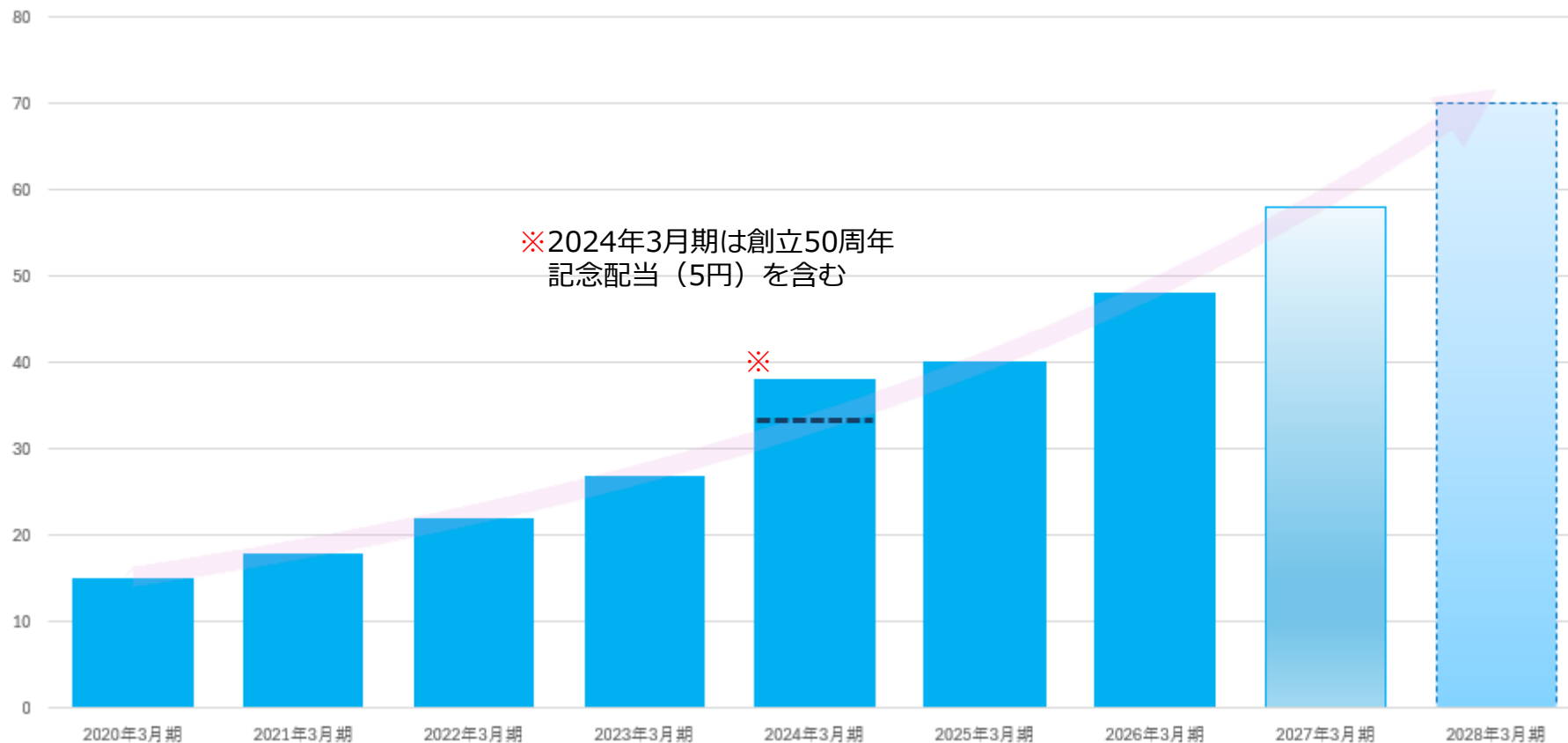
蘇州惠普聯電子有限公司
概要

会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

安定した増配を継続

2020年の上場以来増配を継続しています。今後も安定した増配を継続する方針です。

1株当たり配当額



注) 上記グラフは増配を継続した場合のグラフです。実際の配当額は業績等を勘案して決定します。この配当をお約束するものではありません。

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN